

放熱材料Line-Up

Heat dissipation material lineup

特長 Features

- 大電流、高放熱、高密度化など多彩な用途に対応した基板技術を御提供。
Large current, high heat dissipation and high density technologies for various applications.
- 量産メーカーとして量産性、高信頼性を確保した技術開発を実践。
As a mass-production PCB manufacturer, we practice technological development that ensures mass productivity and high reliability.

代表グレード材料物性値一覧

代表グレード	熱伝導率 (W/m・K)	膜厚 (μm)	絶縁破壊強度 (kV-AC)	ガラス転移点 (°C)
M2P	1.5	80	6.0	110
M3T	3.0	70	6.0	150
L3TV (低弾性)	3.0	100	3.5	非開示
L4TV (低弾性)	4.0	100	3.5	非開示
H5R	5.0	120	5.0	200
H8R	8.0	120	4.5	300
H10ARV (低弾性)	10.0	130	4.5	非開示
H10AR	10.0	120	6.0	219
H15D	14.0	125	9.5	200
H15AR	15.0	130	8.0	227

※上記数値は代表値であり保証値では御座いません。

放熱絶縁材料マップと開発ターゲット

